

SAP専用ドライフィルム剥離液

R-100

R-100は、SAP:Semi-Additive Processでの微細配線形成に適した有機アミン系のドライフィルムレジスト剥離液です。

剥離片が微細な為、剥離残渣が残りにくい等の特徴があります。

特徴

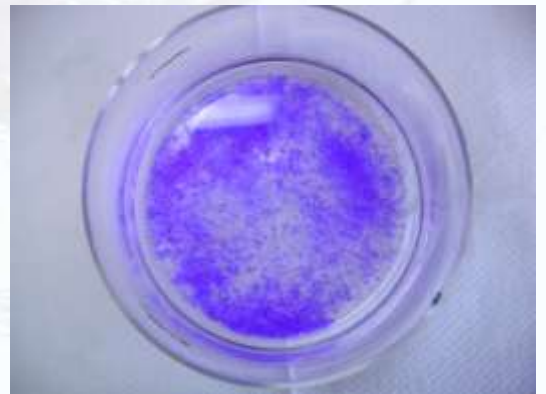
- SAP専用のドライフィルム剥離液です。
- 低スプレー圧 (min: 0.8kg/cm²) あるいは浸漬での処理が可能です。
- 苛性ソーダと比較して銅のアルカリ焼けを低減化可能です。
- 苛性ソーダと比較して、ハンダへのアタックを抑制する事が出来ます。

剥離片比較

『3%NaOH』



R-100



※処理条件

液量: 120ml 液温: 50℃ 浸漬処理 40μ mドライフィルムレジスト 0.012m² (液負荷0.1m²/リットル)



性 状

主成分	:	有機アミン
外観	:	無色透明～淡黄色液体
比重	:	1.04
pH	:	12.1

標準使用方法

製品濃度	:	主成分 30% 剥離促進剤 6.0%
使用方法	:	純水または工業用水にて6倍に希釈。
濃度管理幅目安	:	主成分 5.0%±0.5% 剥離促進剤成分 1.0%～2.0%
液温	:	50℃
必要スプレー圧	:	0.8kg/cm ² 以上
リフトポイント	:	20～45sec程度※ ※25μmDFRの場合
処理時間	:	リフトポイントの1.5倍以上
補充方法	:	枚数カウンターにて補充液R-101を添加 また、液面調整用にR-100希釈液を投入します。

関連製品

R-101 (補充液)
自動液管理装置 (DFR-100)

※ご使用になる前に、あらかじめ技術資料ならびに安全データシート (MSDS) をご参照ください。

製造元  三菱ガス化学株式会社
MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.

販売元  菱江化学株式会社
RYOKO CHEMICAL COMPANY, LTD.

本 社 東京都中央区日本橋本町4丁目12番20号 PMO日本橋本町
Tel 03-6861-0057 (表面処理営業部)

大阪支店 Tel 06-6202-6531

福岡支店 Tel 092-473-7780

名古屋支店 Tel 052-571-5421

仙台支店 Tel 022-225-1577